

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 券商策略会
参与单位名称	大成基金（12月2日） Monolith Management（12月2日） Trivest Advisors（12月2日） 富达基金（12月2日） Keystone Investors（12月2日） 中信证券（12月2日） 弢盛资产管理（12月2日） 瑞银集团（12月2日） 华创证券策略会（12月3日） 申万宏源证券（12月4日） 国泰基金（12月4日） 上海新传奇基金（12月4日） 和谐汇一资产管理（12月4日） 华富基金（12月4日） 平安资管（12月4日） 平安基金（12月4日） 博时基金（12月4日） 东方财富证券（12月4日）

	<p>海富通基金（12月5日）</p> <p>华创证券（12月5日）</p> <p>中汇资本（12月9日）</p> <p>中信建投证券（12月9日）</p> <p>交银基金（12月10日）</p> <p>华泰证券（12月10日）</p> <p>光大证券（12月10日）</p> <p>招商基金（12月10日）</p> <p>华福证券（12月17日）</p> <p>财通资管（12月17日）</p> <p>民生证券策略会（12月23日）</p> <p>西部证券策略会（12月25日）</p>
时间	2025年12月2日—12月25日
地点	公司会议室、深圳、上海
上市公司接待人 员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸯
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、PCB 行业发展趋势</p> <p>2025年以来，国内外云解决方案提供商持续提升算力中心投入，AI 算力数据中心服务器、交换机、光模块等终端需求延续强劲态势，PCB 产业直接受益，以高多层板及高多层 HDI 板为主的细分市场需求快速攀升，促进下游 PCB 企业投资力度加大。行业知名研究机构 Prismark 预估 2025 年 PCB 产业营收和产量分别成长 15.4% 和 9.1%，其中与 AI 服务器和交换机相关的高多层板及 HDI 板增长最为强劲，2024-2029 年产能复合成长率分别高达 22.1% 和 17.7%。</p> <p>二、公司核心竞争力</p> <p>公司依托创新的自主研发模式，不断提升综合竞争能力。公司以细分市场及应用场景为中心，依托细分场景研究平台、各产品研发平台及专业技术研究平台，链接终端客户及 PCB 龙头企业等上</p>

下游产业链开展研发合作，持续挖掘不同细分场景下的 PCB 制程难点与痛点，突破各细分场景现有工艺瓶颈并满足前瞻需求，并通过各细分场景工艺的自我迭代及提升，持续确保公司产品及解决方案的竞争优势，为下游 PCB 行业客户提供各细分市场（场景）一站式最优加工解决方案。

同时，公司业务模式创新发展，通过布局 PCB 生产关键工序及多品类产品为客户提供一站式解决方案，实现了应用场景、技术、供应链、设备与材料、产品、工序、客户的多维协同，并创造性地发挥协同优势，放大客户、供应链及产业链伙伴、公司整体价值，不断提升公司产品的技术和客户服务能力，助力下游客户提升综合竞争力，更好的满足不断演进的 PCB 先进制造需求。

三、公司产品情况

随着数据量的急剧增长，AI 服务器、高速交换机等终端单通道 112/224Gbps SerDes 设计被广泛采用，需要更高层数、更高密度的高速多层板及高多层 HDI 板来承载，为确保高速 PCB 的信号完整性，对孔、线路及成品品质提出更高要求。

在对 PCB 专业加工设备的需求方面，无论高速材料的变更，还是厚径比的上升，都导致机械钻孔效率大幅降低，加工同样面积的 AI PCB 产品所需设备数量大幅增加；而信号完整的提高，背钻孔数提升的同时加工精度要求更高，高精度背钻设备需求量增多。除公司原有优势产品—经典双龙门设计机械钻孔机持续获得客户复购外，新开发的具有 3D 背钻功能的钻测一体化 CCD 六轴独立机械钻孔机，可实现超短残桩及超高位置精度的背钻孔加工，也已获得行业终端客户的认证及多家高多层板龙头企业的大批量采购；而针对高多层 HDI 板的加工需求，除以上提到的机械钻孔机产品需求外，还需要更多的激光钻孔机来满足多阶堆叠盲孔或深盲孔加工，公司研发的高功率及能量实时监测的多规格激光钻孔机可实现大孔径及跨层盲孔的高品质加工。

另外，AI 智能手机、800G⁺光模块等逐步采用类载板，带动了微小孔、槽及外形的高精度加工需求，公司提供新型激光加工方案，突破传统 CO₂ 激光热效应大的瓶颈，实现微小孔钻孔及超高精度外型的成型加工的高品质要求，为行业新兴应用提供新动力，已获得下游客户工艺认可及正式订单。

公司相关设备方案不断进行优化，赋能下游 PCB 主力厂商突

	破 AI 服务器产业链终端客户更复杂设计带来的生产技术瓶颈，提供满足 AI 服务器等大厚板日益增加的高厚径比、更严格阻抗公差、更高信号完整性、更高电性能需求的高可靠性加工方案，并在产能和交付方面具有极大的区位优势，助力下游客户快速扩大增长强劲的 AI PCB 市场竞争力。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 12 月 30 日